

DA 90B 固晶膠 产品技术数据表

高导热性

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 90B 是一款二氧化硅填充型、高导热、无溶剂、快速固化的热固性非导电固晶膠。该材料对多种基板及裸芯片具有优异的附着力, 适用于小尺寸及大尺寸芯片贴装应用。DA 90B 可通过点胶或印刷工艺进行施胶, 并在实际应用中表现出优异的可靠性及高温回流焊兼容性能

物理特性

产品名称	DA 90B 固晶膠
填料	二氧化硅
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	2.5 g/cc
粘度 (ASTM D-1384)	10–50 kcp
固化后材料性能	
拉伸强度	56 MPa
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	35 ppm/°C
杨氏模量	0.5–10 GPa
导热系数	2–5 W/m·K
体积电阻率	>10 ⁸ Ω

芯片剪切强度(Kg/mm2)	2x2mm Silicon die on Pd: 2.0 2X2mm Au silicon die on bare Cu: 2.5 2x2mm Au silicon die on Au: 2.3
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过

应用工艺

在 150–170 °C 下固化 30–50 分钟。

注:固化时间不包括胶层达到设定固化温度所需的升温时间。可根据具体工艺条件评估并调整其他固化曲线。

储存与保质期

在 -10 °C 至 -20 °C 条件下, 于密封原包装中储存, 保质期为 6 个月。超过保质期储存可能导致粘度升高。请防止材料受潮、挥发及外来污染物侵入, 否则可能影响其工艺性能。

安全说明

DA 90B 为环保、无毒材料。但在操作过程中仍建议遵循基本的工业卫生规范。详细安全信息请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装规格

DA 90B 導電膠提供10cc, 和30cc, 兩種包裝規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息, 請聯繫YINCAE公司。